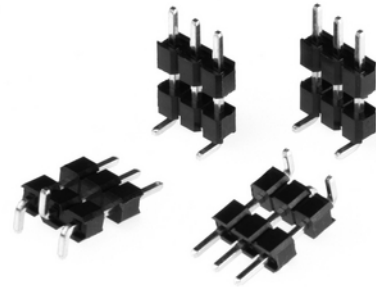


# 9533 / 9133

## SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-reihig SMT Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, Single/Double Row

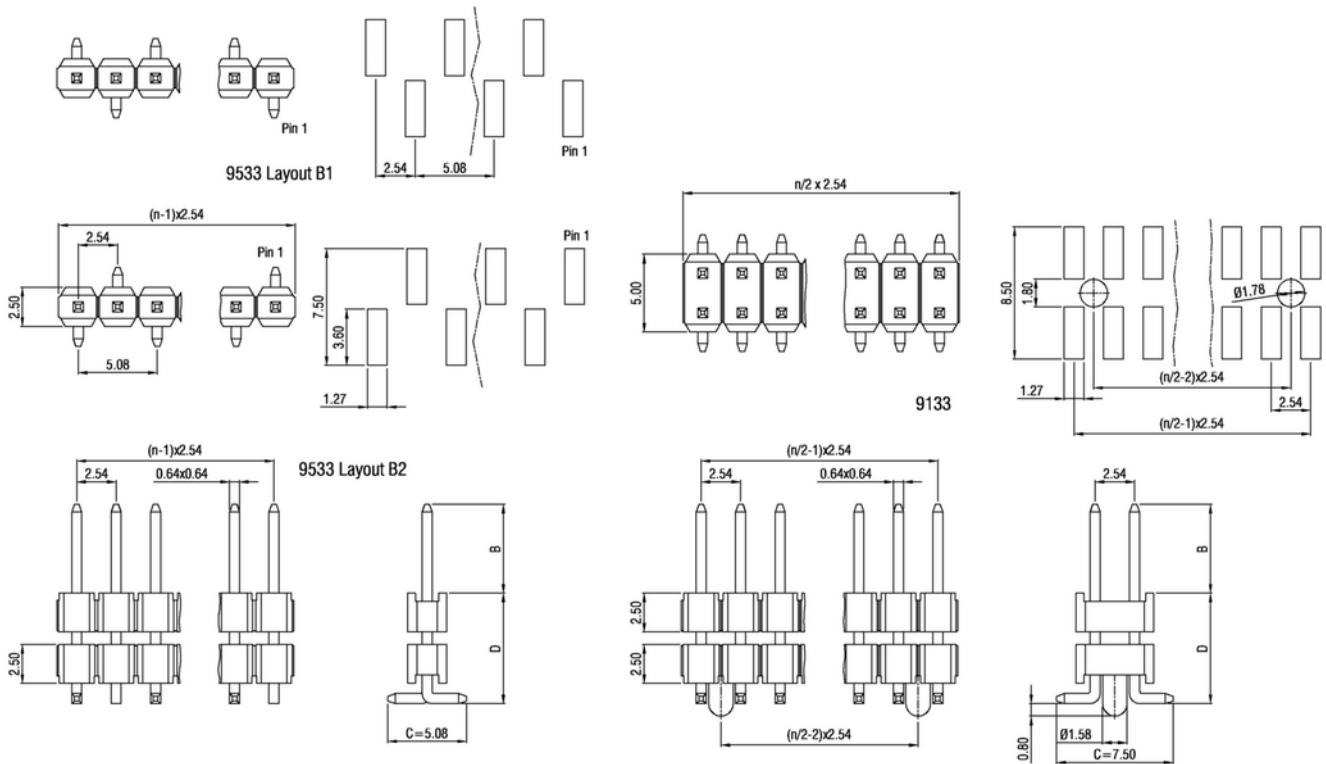
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>DC</sub> <i>1KV<sub>DC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +125°C <i>-40°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Mate with Female Headers:  
**3490 3491** etc.  
Weitere siehe Kapitel R



Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*	Layout*	Loc. Pegs*	Packaging*
<b>9533</b>	<b>14</b>	<b>08</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>00</b>	<b>PPST</b>
<b>Gestanzte/geprägte Kontakte</b> <i>Stamped/formed contacts</i>	<b>14</b> B=5,70 D=6,30mm	<b>02-40</b> Einreihig <i>Single row</i>	<b>00</b> Vergoldet <i>Gold plated</i>	<b>0</b> (Nur Serie 9133) <i>(9133 series only)</i>	<b>00</b> Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i>	<b>ST</b>
<b>9533</b> Einreihig <i>Single row</i>	<b>15</b> B=5,70 D=7,10mm	<b>04-80</b> Zweireihig <i>Double row</i>	<b>50</b> Verzinkt <i>Tin plated</i>	<b>1</b> Layout B1 (9533) <i>Layout B1 (9533)</i>	<b>10</b> Mit Pos.hilfen (9133) <i>With loc. pegs (9133)</i>	<b>PPTR</b>
<b>9133</b> Zweireihig <i>Double row</i>	<b>16</b> B=5,70 D=10,10mm	<b>99</b> Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i>	<b>60</b> Sel. Au/Sn <i>Duplex plating</i>	<b>2</b> Layout B2 (9533) <i>Layout B2 (9533)</i>		

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.  
More pin length and plating options on request.

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

Lieferformen / Packaging Options:
<b>ST</b> In Stangen ohne Pick&Place-Pad / <i>In tubes w/o Pick&amp;Place-Pad</i>
<b>PPST</b> In Stangen mit P&P-Pad / <i>In tubes with P&amp;P-Pad</i>
<b>PPTR</b> Tape & Reel mit P&P-Pad / <i>Tape &amp; Reel with P&amp;P-Pad</i>

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
WEBSITE www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

